(NATURAL SCIENCE)

Vol. 63 No. 4 JUCHE106 (2017).

규칙적인 기공구조를 가진 TiO2-C-Cu재료의 합성

리성균, 리문혁, 최문일

지금까지 TiO_2 -C재료합성에 대한 선행연구결과[1-3]들은 발표되였지만 고속충방전리 티움이온전지에 리용할수 있는 금속을 삽입한 TiO_2 -C-Cu복합재료를 합성하고 그 특성을 밝힌 연구결과는 발표된것이 없다.

우리는 용매의 증발유도자체조직화(EISA)과정과 결정화과정을 통하여 탄소골격과 Cu 나노립자를 다같이 포함한 리티움이온전지용TiO₂복합재료를 합성하였다.

실 험 방 법

시료로는 계면활성제 EO₂₀PO₇₀EO₂₀(P123, 분자량 5 800), Ti(OBu)₄, TiCl₄, Cu(CH₃COO)₂, 폐놀, 포름알데히드수용액(37%), NaOH, 알콜을 리용하였다.

재료합성 티탄전구체(TiCl₄(0.85g)-Ti(OBu)₄) 1.5g과 페놀수지의 20% 알콜용액 1g, P123 12mL, 초산동(0.1g)의 5% 에틸알콜용액을 0℃에서 교반하면서 혼합하였다. 5min후 붉은색의 용액을 뚜껑이 있는 시계접시에 넣어 35℃의 건조로에서 48h동안 건조시켜 얻은 투명한 막을 100℃에서 24h동안 열처리하여 복합재료를 얻기 위한 원료를 제조하였다. 이것을 질소분위기의 관식로에서 0.5℃/min의 속도로 온도를 높이면서 350℃에서 2h동안, 500℃에서 2h동안 유지하여 TiO₂-C-Cu-350과 TiO₂-C-Cu-500을 얻었다.

비교를 위하여 초산동을 넣지 않은 조건에서 우와 같은 방법으로 규칙적인 기공을 가진 TiO₂-C를 얻었다.

생성물을 소결온도에 따라 TiO₂-C-350과 TiO₂-C-500으로 표시하였다.

재료분석 재료의 구조는 X선회절분석기(《D/MAX 2550》)와 고분해능투과전자현미경 (《JEM-2010》)으로, 모양과 크기는 주사전자현미경(《JSM-6360》)으로, 표면원소조성은 X 선에네르기분산스펙트르분석기(《EDAX/Genisis》)로, 조성은 열무게분석기(《NETZSC HSTA 499F3》)로, 원자가상태와 결합방식은 X선광전자분석기(《Kratos Axis Ultra DLD》)로, 비표면적과 기공크기분포는 N₂흡탈착등온선분석기(《ASAP-2020》)로 분석하였다.

실험결과 및 해석

기공을 가진 TiO2복합물시료의 SAXRD도형은 그림 1과 같다.

그림 1의 곡선 1에서 보는바와 같이 2θ =1°에서 1개의 약한 회절봉우리가 나타나는데 이 것은 기공이 존재한다는것을 보여준다. 한편 곡선 2의 특정봉우리세기가 곡선 1보다 매우 크 며 이것은 TiO_2 -C-350과 TiO_2 -C-Cu-350에서 보다 규칙적인 기공이 형성되였다는것 즉 소결후에 기공구조가 보다 질서있게 배향된다는것을 보여준다.

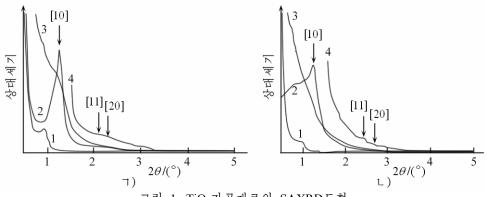


그림 1. TiO₂기공재료의 SAXRD도형 ㄱ) TiO₂-C, ㄴ) TiO₂-C-Cu 1-소결전, 2-350℃ 질소분위기, 3-500℃ 질소분위기, 4-곡선 2를 3배 확대한것

그림 1에서 보는바와 같이 복합물시료는 [10], [11], [20]면에서 2차원6면체인 P6mm대 칭면[3]을 가진다는것을 알수 있다. TiO₂-C-Cu-350의 회절봉우리는 TiO₂-C-350에서와 위치에서는 그리 큰 변화는 없고 [10]면의 면간거리는 6.9nm이다. 따라서 Cu의 첨가가 기공구조에 영향을 주지 않는다는것을 알수 있다.

폐놀포름알데히드수지를 첨가하지 않으면 TiO₂의 규칙적인 기공구조는 350℃에서 소결할 때 파괴되지만 탄소골격이 일정한 정도로 계에 포함되면 TiO₂결정의 빠른 성장을 억제하고 기공구조를 안정하게 한다. 소결온도가 500℃일 때에는 기공구조가 파괴되여 [10] 면의 회절봉우리는 거의 사라지고 [11], [20]면의 회절봉우리는 완전히 사라진다.

탄소첨가량이 30%이하일 때 500℃에서 소결하면 탄소골격은 기공구조를 유지하지 못한다. 이로부터 TiO2골격의 성장이 규칙적인 기공구조붕괴의 주요원인이라는것을 알수 있다.

TiO₂-C-Cu-350은 전형적인 예추석형구조(JCPDS: 21-1272)를 가진다. Debye-Scherrer방 정식으로 계산한 결정의 평균크기는 3nm이다.

TiO₂-C-Cu시료의 TG곡선은 그림 2와 같다.

그림 2에서 보는바와 같이 질소분위기에서 소성한 TiO₂-C-Cu시료에서는 200℃이하에서 약 10%의 질량손실(물과 용매의 증발)과 200~350℃에서약 54%의 질량손실(P123과 가용성폐놀포름알데히드수지의 분해와 탄화)이 나타난다.

TiO₂-C-Cu-350의 XPS스펙트르에서 932.2, 933.5eV의 2개의 봉우리는 각각 Cu-Cu(금속)와 Cu-O화학결합에 해당된다. 이것은 350°C에서 나노 Cu립자가 TiO₂-C-Cu속에 끼여들며 적은 량의 CuO 도 존재한다는것을 보여준다.

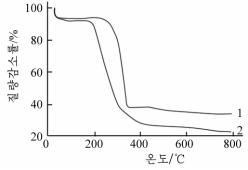


그림 2. TiO₂-C-Cu시료의 TG곡선 1-N₂분위기, 2-N₂(80%)+O₂(20%) 분위기

열무게분석 및 XPS원소분석에 의하면 TiO₂-C-Cu-350과 TiO₂-C-350에서 매 성분들의 조성은 각각 TiO₂ 70%, C 25%, Cu 5%; TiO₂ 70%, C 30%이다.

TiO₂-C-Cu-350의 TEM사진은 그림 3과 같다.

그림 3에서 보는바와 같이 TiO₂-C-Cu-350은 규칙적인 기공을 가진 구조를 가진다.

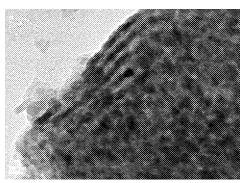


그림 3. TiO₂-C-Cu-350의 TEM사진

복합재료의 평균기공직경은 약 5.05nm이고 TiO_2 과 가용성페놀포름알데히드수지중합물들이 증발유도 자체조직화과정에 고르롭게 혼합되며 동나노립자들은 TiO_2 -C-Cu-350의 기공벽속에 잘 분산되여있다.

TiO₂-C-Cu-350의 구조적특성은 표와 같다.

표. TiO₂-C-Cu-350의 구조적특성

기공직경	기공벽두께	립자크기	비표면적
/nm	/nm	/nm	$/(m^2 \cdot g^{-1})$
5.05	2.92	2.80	161.9

표에서 보는바와 같이 N_2 흐름속에서 소결한 TiO_2 -C-Cu-350의 립도는 7.97nm, 기공벽의 두께는 2.92nm, 결정의 크기는 2.80nm이다.

맺 는 말

증발유도자체조직화과정을 통하여 합성한 TiO_2 -C-Cu기공재료는 직경이 약 5.05nm인 규칙적인 기공구조를 가지며 비표면적은 $161.9m^2/g$ 에 달한다.

탄소는 소결과정에서 TiO_2 나노결정의 과도한 성장을 억제하며 동나노립자는 기공벽속에 잘 분산되여있다.

참 고 문 헌

- [1] Y. Zhou et al.; Chem. Commun., 47, 4944, 2011.
- [2] Y. G. Guo et al.; Adv. Mater., 19, 2087, 2007.
- [3] D. Y. Zhao et al.; J. Am. Chem. Soc., 120, 6024, 1998.

주체105(2016)년 12월 5일 원고접수

On the Synthesis of TiO₂-C-Cu Material containing the Ordered Mesoporous Structure

Ri Song Gyun, Ri Mun Hyok and Choe Mun Il

A TiO_2 -C-Cu material prepared via an evaporation induced of self-assembly (EISA) process was composed of the ordered mesoporous structure with a diameter of about 5.05nm and its specific surface area reaches to $161.9m^2/g$.

The existence of carbon prevents the excessive growth of TiO₂ nanocrystals during the calcination and Cu nanoparticles are highly dispersed in porous walls.

Key words: TiO₂-C-Cu, mesoporous structure, nanomaterial